

2024年5月14日

各位

## JX金属グループ 中長期の事業戦略および事業目標について

JX金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、この度、2023年5月に公表した2023-2025年度中期経営計画を見直し、足元の取組みおよび事業環境を踏まえた中長期の事業戦略および事業目標を策定しましたので、お知らせいたします。当戦略および目標の確実な実行・実現にグループ一丸となって取り組み、半導体材料・情報通信材料のグローバルリーダーとして、先端素材で社会の発展と革新に貢献することを目指します。

### 1. 経営方針

当社グループは、2019年6月にJX金属グループ2040年長期ビジョンを策定し（2023年5月に一部改定）、「装置産業型企業」から「技術立脚型企業」への転身により、激化する国際競争の中にあっても高収益体質を実現し、半導体材料・情報通信材料のグローバルリーダーとして持続可能な社会の実現に貢献することを基本方針といたしました。この方針の下、半導体材料セグメントと情報通信材料セグメントからなるフォーカス事業を成長戦略のコアとして位置づけ、先端素材分野での技術の差別化や市場創造を通じて、市場成長以上の利益成長を目指しております。基礎材料セグメントからなるベース事業は、最適な規模の事業体制の下で、銅・レアメタルの安定供給を通じてフォーカス事業を支えるとともに、ESG課題の解決に貢献してまいります。

### 2. 事業環境の見通し

#### (1) フォーカス事業：半導体材料セグメント

- 半導体ロジック・メモリ市場は、2017年から2022年にかけて年率6.1%<sup>(※1)</sup>で拡大してきました。2023年は市況の調整が続いたものの、今後は生成AIの伸長による市場牽引が本格化するとともに、電気自動車等の普及拡大により、2023年から2027年にかけて年率7.6%<sup>(※1)</sup>の成長が予想されております。
- PVD<sup>(※2)</sup>に用いられる当社の主力製品である半導体用スパッタリングターゲットは、ロジック・メモリをはじめとした各種の半導体デバイスの製造に用いられており、半導体市場が成長し、主要顧客の新工場稼働が予定されていることもあり、使用量増加が期待されます。加えて、多層化・微細化が必要な先端半導体の成長に伴い、PVDにおける半導体用スパッタリングターゲットの使用量増加に加えて、CVD<sup>(※3)</sup>・ALD<sup>(※4)</sup>による薄膜形成ニーズも高まることを見込まれます。中長期的には、チップレットの普及も予想されており、チップレット間を繋ぐ配線等の用途での成膜需要の拡大を見込んでおります。

<sup>1</sup> 出典：TechInsights Inc. “Worldwide Silicon Demand History and Forecast”（2024年3月時点、シリコンウエハ出荷面積ベース）

<sup>2</sup> Physical Vapor Deposition（物理気相成長法）の略。スパッタリング法は代表的なPVDプロセスのひとつであり、真空状態の装置内でスパッタリングターゲットにアルゴンイオンを衝突させ、放出したターゲット原子/分子をシリコンウエハやガラス等の基盤上に付着させ、薄膜を形成する技術。

<sup>3</sup> Chemical Vapor Deposition（化学気相成長法）の略。化学反応を活用して薄膜を形成する方法。

<sup>4</sup> Atomic Layer Deposition（原子層積層法）の略。原子層レベルで膜厚を制御して薄膜を形成する方法。

## (2) フォーカス事業：情報通信材料セグメント

- ・ 2024年3月期のエレクトロニクス製品の市況調整の影響により、主力製品であるFPC<sup>(※5)</sup>向け圧延銅箔の販売が落ち込んだものの、需要はすでに底打ちしており、2025年3月期からは再び成長軌道に回帰すると考えております。電子機器製品等に搭載されるFPCの面積は、2023年から2028年にかけて年率7.1%<sup>(※6)</sup>の成長が予想されております。
- ・ 今後は、AI搭載等によるスマートフォンやパソコン向け部材の更なる高機能化・微細化に加え、スマートウォッチやスマートグラスといったウェアラブル等の周辺機器の市場成長による圧延銅箔の使用拡大が見込まれます。また、世界的なEV販売台数の増加にともない、配線用や誤作動防止のために用いられるシールド材用の圧延銅箔の使用量が拡大するとともに、中長期的には産業機械、ロボット等の分野において小型化、軽量化が進み、複雑な動きに対して疲労耐性の強い圧延銅箔の使用量拡大が見込まれております。
- ・ 積層セラミックコンデンサ(MLCC)の内部電極に使用される超微粉ニッケルについては、2024年3月期末に需要は底打ちしており回復基調にあるものの、本格的な回復には時間を要するものと考えております。一方で、2025年3月期中には、AIを搭載する高機能通信機器の普及や、EVや自動運転の普及に伴う電装化の進展、データサーバーやAIサーバー等の成長が需要を牽引し、市場は成長軌道に回帰していくものと想定しております。

## (3) ベース事業：基礎材料セグメント

- ・ 脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの導入が拡大するとともに、様々な産業や領域において電化が進行しており、中長期的に銅素材の需要拡大が見込まれます。例えば、電気自動車では、モーターコイルやバッテリーなどにガソリン車の約4倍の銅が使用されております。銅需要拡大の一方で、既存鉱山からの銅鉱石やリサイクル原料の供給量には限界があり、銅の需給はひっ迫することが見込まれており、銅価は堅調に推移していくものと考えられます。
- ・ 技術革新、製品寿命の短期化、人口増加等の要因により電気・電子機器の廃棄物であるE-Wasteの発生量が増加傾向にあり、2020年に55.5Mtであったものが2030年には82Mtに達する見通しです<sup>(※7)</sup>。一方で、脱炭素に向けた世界的な環境意識の高まりにより、リサイクル原料確保への動きが加速していることに加えて、環境規制強化の流れもあり、リサイクル原料の調達コストは上昇することが予想されます。
- ・ アジア域内での製錬所建設が進むことにより、銅地金の販売環境の悪化が見込まれております。

## 3. 中長期の事業戦略

### (1) フォーカス事業：半導体材料セグメント

- ・ 当社は、強みである高純度化、組成・組織制御、表面処理、分析評価等の技術を活かして、半導体製造装置メーカーとの強固な関係を構築し、標準材料への指定を獲得することで、半導体メーカーに対して高品質の製品を安定的に供給しております。当社の主力製品である半導体用スパッタリングターゲットは、半導体の主要配線層に用いられる銅や銅合金、そのバリア層に用いられるタンタルに加えて、半導体の回路形成やトランジスタ部分等に用いられるチタン、コバルト、タングステン等の複数の製品で世界シェアNo.1<sup>(※8)</sup>となっております。
- ・ 今後は、半導体需要の拡大、特に先端半導体の成長を見据えて、引き続き顧客ニーズに合致する開発・材料提案を実施するとともに、市場成長を捕捉する拡張投資を実行してまいります。2022年3月に茨城県ひたちなか市、および米国アリゾナ州に新工場建設のための大規模用地を取得し(それぞれ約24万㎡、約26万㎡)、将来的な需要の急拡大が見込まれ、収益性が高い半導体用スパッタリングターゲットを中心とした半導体材

<sup>5</sup> Flexible Printed Circuits (フレキシブルプリント基板) の略。絶縁性を持ったベースフィルムと銅箔等の導電性金属を貼り合わせた基材に電気回路を形成した基板。

<sup>6</sup> 出典：Prismark Partners LLC “The Printed Circuit Report Fourth Quarter / February 2024”

<sup>7</sup> 出典：UNITAR “The Global E-waste Monitor 2024”

<sup>8</sup> 出典：当社の依頼により実施された外部調査機関による調査 (2021年実績、AI系を除く半導体用ターゲット市場における当社のシェア、販売金額ベース)

料の生産能力増強を計画しております。アリゾナ州の新工場については2024年7月より順次稼働を開始する予定です。

- ・ 加えて、幅広いラインナップの次世代半導体材料の強化を図ってまいります。データセンター数の増加やモバイル通信量の増加、センシング技術の高度化等により、結晶材料<sup>(※9)</sup>分野の成長が見込まれておりますが、当社の高純度化、組成制御、温度制御の技術を駆使し、高品質な結晶材料を市場に供給することにより、結晶材料事業を半導体材料セグメントにおける次世代の収益の柱とするべく取り組みを進めております。2024年4月には技術本部 結晶材料事業推進部を立ち上げ、データセンター等で使用される受発光素子の素材となるInP（インジウムリン）や、赤外線検出器や放射線検出器等の用途に用いられるCdZnTe（カドミウムジニクテル）等の分野を強化する体制を構築いたしました。また、半導体製造プロセスに用いられるリソグラフィ・フォトリソグラフィ用材料、次世代半導体材料として期待されているCVDやALD向け材料等の分野においても迅速かつ着実な事業規模拡大を図ります。

## (2) フォーカス事業：情報通信材料セグメント

- ・ 当社はこれまで、優れた耐屈曲性・耐振性等を有する銅箔の生産技術を活かし、エンドユーザーに対して直接材料を提案する市場開発型アプローチを実行することにより事業拡大を図ってまいりました。主力製品であるFPC向けの圧延銅箔の世界シェアはNo.1（2022年実績76.5%）<sup>(※10)</sup>となっております。
- ・ 今後は、既存用途における高機能化・微細化ニーズを捕捉するとともに、ウェアラブルやモビリティ、産業機械、ロボット等の分野における需要増加の機会を捉えた事業拡大や、高付加価値製品へのシフトによる製品ポートフォリオの見直しを行います。また、圧延・表面処理・電解技術といった当社のコア技術を活用して新規事業領域の製品開発を目指すとともに、外注加工の活用や生産シフト見直し、設備の多機能化等により需要変動に強い事業体制の構築を行います。加えて、資材やエネルギーコスト等の上昇を製品に転嫁することによる価格適正化活動を実施することで収益性の改善を目指します。
- ・ 積層セラミックコンデンサ（MLCC）向け超微粉ニッケルへの今後の需要増加に対応するため、当社の子会社である東邦チタニウム株式会社にて、新工場を建設し生産能力を増強することを決定しており、2026年3月期中の稼働開始を予定しております<sup>(※11)</sup>。

## (3) ベース事業：基礎材料セグメント

- ・ 当社グループで使用する原料として必要な鉱物資源を安定的に確保するべく、銅のみならず、タンタルやチタン等のレアメタル鉱山の開発検討を行ってまいります。一方で、鉱物資源開発事業とリサイクル事業の最適な組み合わせでの事業規模を追求すべく、2023年3月期にカナダ最大のE-Waste回収・処理事業者であるeCycle Solutions Inc.の株式を取得した一方、2023年3月期から2024年3月期にかけて資源事業におけるカセロネス銅鉱山、ロス・ペランブレス銅鉱山の一部持分譲渡、金属・リサイクル事業におけるLS-Nikko Copper Inc.の全株式売却、パンパシフィック・カッパー株式会社（以下「PPC社」）の一部持分譲渡等を行いました。
- ・ 2022年に策定したサステナブルカッパー・ビジョンの実現に向けた取り組みを行います。具体的には、銅精鉱とリサイクル原料の双方を活用した安定供給を実現し、CO2排出削減、資源循環、責任ある調達を社外企業・大学との提携等を通じて促進いたします。また、化石燃料をほぼ使用しないグリーンハイブリッド製錬<sup>(※12)</sup>の高度化を進め、電気銅の高付加価値化を目指します。さらには、資源循環と脱炭素をお客様との共

<sup>9</sup> 結晶とは単一もしくは複数の元素の原子、分子またはイオンが規則正しく配列している固体のことである。高品質の結晶材料を用いることにより、素子や検出器の効率をより高めることができる。

<sup>10</sup> 出典：富士キメラ総研”2023 エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧”（2022年実績、FPC向けのみ、出荷数量ベース）

<sup>11</sup> <https://ssl4.eir-parts.net/doc/5727/tdnet/2233074/00.pdf>

<sup>12</sup> 銅精鉱自ら発する酸化反応熱を最大限に活用し、化石燃料をほぼ使用せずにリサイクル原料の増処理を行う製錬方法。拡大する需要を支える安定供給体制の構築とESG（脱炭素や資源循環等）を重視した生産と供給の両立を目指す。

創で推し進めるべく、マスバランス方式を用いた100%リサイクル電気銅を上市することを発表しております<sup>(※13)</sup>。

- ・ 採掘された資源を廃棄せずに再利用し続けるサーキュラーエコノミーの実現に向けて、三菱商事株式会社（以下「三菱商事」）とともに、廃家電や廃電子機器、廃車載用リチウムイオン電池等の再利用を推進する会社を新たに設立し、2024年7月を目途に事業を開始する予定です<sup>(※14)</sup>。三菱商事の持つ産業横断型のグローバルなネットワークや知見を活用することで、リサイクル原料集荷やサプライチェーン全体の連携を強化し、銅やレアメタル等の非鉄金属資源の廃棄の最小化を目指します。

#### (4) キャピタルアロケーション方針

- ・ 先端ノードをはじめとして今後伸長する半導体需要を確実に捕捉し、高品質な素材を安定的に供給するためにも、半導体材料セグメントへの成長投資を最優先にしつつ、有利子負債の削減も並行して進めてまいります。
- ・ 今後3年間で約2,700億円の投資を予定しております。個々の投資については、その必要性や投資効率を精査のうえで実行いたします。
- ・ 主な投資先であるひたちなか新工場については、2024年3月6日付プレスリリースの通り、直近の各製品における投資の必要性を踏まえて改めて精査を行った結果、一部の投資を見送り、収益性が高く、需要の急拡大が見込まれる半導体用スパッタリングターゲット等の半導体関連の投資を中心に実施することといたします。それにより、2023年3月期からの投資総額は当初想定約2,000億円規模から約1,500億円規模となる見込みです<sup>(※15)</sup>。

#### (5) 構造改革

- ・ 2023年5月に構造改革チームを新設し、ベース事業を中心とした組織再編、運転資本の改善、設備投資の最適化、拡販・売価見直し、全社での間接費を含むコストの最適化を通じた構造改革を進めております。
- ・ 組織再編については、上述の通りPPC社の一部持分譲渡等を実施しており、2024年3月期に有利子負債を約2,000億円削減いたしました。これらの組織再編により、2025年3月期以降、連結営業利益に占めるフォーカス事業の構成比率が増加し、連結営業利益率が大きく上昇する見込みです。
- ・ 加えて、在庫基準や売掛金・買掛金サイトの適正化、設備投資額や調達コスト、外注費用の見直し等を通じて、収益性および資本効率の更なる改善を図っております。2024年3月期においては、約30億円の営業利益の改善（対2023年3月期実績）、約200億円の運転資本改善（対2023年3月期実績）、約550億円の投資額削減（対2024年3月期予算）を実現いたしました。2025年3月期においても同額以上の営業利益改善を目指しております。運転資本改善、投資の最適化についても継続的に実施をしてまいります。

<sup>13</sup> [https://www.jx-rmm.com/newsrelease/2023/20240131\\_01.html](https://www.jx-rmm.com/newsrelease/2023/20240131_01.html)

<sup>14</sup> [https://www.jx-rmm.com/newsrelease/2024/20240422\\_01.html](https://www.jx-rmm.com/newsrelease/2024/20240422_01.html)

<sup>15</sup> [https://www.jx-rmm.com/newsrelease/2023/20240306\\_01.html](https://www.jx-rmm.com/newsrelease/2023/20240306_01.html)

#### 4. 中長期の事業目標

当社グループは、上記の事業環境の見通しおよび事業戦略を前提として、以下の中長期事業目標を設定いたしました。

		2023年 3月期 実績	2024年 3月期 実績	2028年3月期目標
営業利益	連結	約720億円	約860億円	CAGR 10% ~ 15% (2024年3月期-2028年3月期)
	フォーカス事業	約550億円	約270億円	CAGR 35% ~ 40% (2024年3月期-2028年3月期)
営業利益率	連結	約4.5%	約5.5%	12% ~ 17%
	フォーカス事業	約15%	約8.5%	15% ~ 20%
	半導体材料セグメント	約23%	約21%	25% ~ 30%
	情報通信材料セグメント	約9.5%	約0.5%	8% ~ 13%
事業別利益構成比	フォーカス事業 <sup>(※16)</sup>	約65%	約25%	67%以上
	半導体材料セグメント <sup>(※16)</sup>	約40%	約25%	45%以上
ROE		約7%	約17%	10%以上
Net Debt/EBITDA <sup>(※17)</sup>		約4.0倍	約2.6倍	1.5倍未満

(目標値策定の前提として、為替は2025年3月期140円/ドル・2026年3月期以降135円/ドル、銅価は2025年3月期以降380¢/lbを使用しております。)

- 2023年3月期にて、カセロネス銅鉱山の運営会社であるSCM Minera Lumina Copper Chile（以下「MLCC社」）株式の51%をLundin Mining Corporationへ譲渡<sup>(※18)</sup>したことに伴う評価損742億円を計上しております。上表の連結営業利益、連結営業利益率、フォーカス事業および半導体材料セグメントの事業別利益構成比、ROE、Net Debt/EBITDAにその影響が含まれております。
- 2024年3月期に実施したMLCC社の株式譲渡等により生じた通算前欠損金が、グループ通算制度によって損益通算されたことで、通算税効果額の精算が行われました。これにより、2024年3月期の当期純利益が持ち上がり、一時的にROEが改善いたしました。
- 今後さらにMLCC社株式の19%の追加売却を予定しており、最終的な譲渡割合は70%になる予定です。

なお、これらの数値目標およびその前提は事業環境の変動等に応じて、今後修正される可能性があります。また、実績値は、当社連結の未監査の数値を使用しているため、今後変更される可能性があります。

以上

<sup>16</sup> 事業共通費用を除いたフォーカス事業(半導体材料セグメント、情報通信材料セグメント)およびベース事業(基礎材料セグメント)の営業利益を基に算出しております。フォーカス事業の営業利益は半導体材料セグメントと情報通信材料セグメントの営業利益の単純合算値です。

<sup>17</sup> Net Debt (有利子負債 - 現預金 (ENEOSグループ金融短期貸付金含む)) ÷ EBITDA (営業利益 + 減価償却費) により算出しております。

<sup>18</sup> [https://www.jx-rtm.com/newsrelease/2023/20230714\\_01.html](https://www.jx-rtm.com/newsrelease/2023/20230714_01.html)

本資料は、当社の企業情報等の提供を目的としており、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘又はこれに類する行為のために作成及び公表されたものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。また、本資料に記載されている当社の目標、計画、見積もり、予測、予想、ターゲットその他の将来情報については、本資料の作成時点において、当社が入手できる情報をもとに、一定の前提に基づく当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、国内外の経済情勢・市場環境、事業活動、他社との競争環境その他様々な要因等により、本資料の内容又は本資料から推測される内容と大きく異なることがあります。したがって、これらの将来に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。